

Lotpastenapplikation

Technologien, Prozessoptimierung, Fehlervermeidung, 9. - 10. März 2015

Seminarinhalt

Der Workshop beginnt mit den notwendigen theoretischen Grundlagen der Lotpastenapplikation. Erläutert werden unterschiedliche Arten des Lotpastenauftrags, Schablonenarten sowie wichtige Druck- und Lotpastenparameter.

Die Teilnehmer/Innen lernen verschiedene Auftragstechniken in der Praxis kennen und abzuschätzen, unter welchen Voraussetzungen welche Technik zum Einsatz kommen kann. Inspektionsmethoden, wie optische Inspektion und 3D-Lotpasteninspektion werden demonstriert und bei mangelhafter Lotapplikation (u.a. Brückenbildung, Verschmierung, Pastenmangel) systematische Problemlösungen aufgezeigt. Daraus werden Strategien zur Fehlervermeidung erarbeitet. Besonderheiten des Pastenauftrags werden ebenso thematisiert wie die Anwendung Kleberdruck.

Die Praxis wird in kleinen Teams an einer hochmodernen industrieüblichen, automatischen Fertigungslinie durchgeführt. Die Prozessparameter werden von den Teilnehmern unter Anleitung optimiert und dokumentiert sowie die Ergebnisse mittels Inspektion bewertet und in der Gruppe diskutiert.

Ziel des Workshops - Lotpastenapplikation

Es werden in Theorie und Praxis die unterschiedlichen Technologien vorgestellt sowie Wege zur systematischen Prozessoptimierung und Fehlervermeidung aufgezeigt. Den Teilnehmern werden mit praktischen Beispielen anschaulich Lösungsansätze dargestellt, die leicht auf eigene Problemstellungen übertragen werden können.

Zielgruppe

OEM mit eigener Elektronikfertigung, Prototypen- und Musterbau sowie Baugruppenfertigungs-Dienstleister. Mitarbeiter/innen aus Fertigung, Arbeitsvorbereitung, Prozesstechnik, Qualitätssicherung und Entwicklung.

Veranstaltungsort

Fraunhofer ISIT, Fraunhoferstraße 1, 25524 Itzehoe

Seminarablauf

Montag

- 08:45 Begrüßung, Einschreibung
- 09:00 Einflussfaktoren im Lotpastendruck
Helge Schimanski, Fraunhofer ISIT, Itzehoe
- 10:00 Jetprinten und Lotpasteninspektion
Helge Schimanski, Fraunhofer ISIT, Itzehoe
- 10:30 Kaffeepause
- 11:00 Praxis des Lotpastenauftrags
Gerätedemo, Schablonentechnik, Raketypen und Lotpasten
- 12:30 Mittagspause
- 13:30 Fehlermöglichkeiten bei der Lotpastenapplikation
Teil 1, Beispiele + Abhilfemaßnahmen
- 15:00 Kaffeepause
- 15:30 Fehlermöglichkeiten bei der Lotpastenapplikation
Teil 2, Beispiele + Abhilfemaßnahmen
- 17:00 Ende des ersten Tages
- 19:00 Einladung zum gemeinsamen Abendessen

Dienstag

- 09:00 3D-Lotpasteninspektion
Einsatzmöglichkeiten und Beispiele
- 10:30 Kaffeepause
- 11:00 Lotpastenapplikation mit dem Jet-Dispenser
Werkzeuge, Programmierung, Gerätedemo
- 12:30 Mittagspause

- 13:30 Besondere Problemstellungen
Lotvolumina, strukturierte Substrate
- 15:00 Kaffeepause
- 15:30 Abschlussdiskussion
Wege zur systematischen Prozessoptimierung und Fehlervermeidung
- 17:00 Ende der Veranstaltung

Referenten/Betreuer

Jan Lähn, Fraunhofer ISIT, Itzehoe
Mikrotechnologe. Seit 2000 in der Prozesstechnik und Analytik für elektronische Baugruppen und Montage von Mikrosystemen tätig; technische Betreuung der ISIT-Linie; langjährige Erfahrung bei der Durchführung von Praxis-Trainings.

Seminarleitung

Helge Schimanski, Fraunhofer ISIT, Itzehoe
Dipl.-Ing. (FH) Physikalische Technik, FH Wedel. Seit 1990 in der Prozesstechnik und Analytik für elektronische Baugruppen und Montage von Mikrosystemen tätig; Leitung der ISIT-Linie und des Rework-Centers. Mitglied im ZVEI Arbeitskreis Repair/Rework und im FED Arbeitskreis Innovative Baugruppenfertigung.

Unterstützung durch weitere ISIT-Mitarbeiter

Lotpastenapplikation

Seminarleitung

Helge Schimanski

Kosten

790,- EUR

Im Preis inbegriffen sind die Kursunterlagen, Pausengetränke und Mittagessen.

Dauer

2 Tage,

Beginn: 1. Tag 08:45, Ende: 2. Tag 17:00 Uhr

Teilnehmerzahl

Maximal 12 Personen

Buchung

Fraunhofer ISIT

Marion Rosemann

Fraunhoferstr. 1, 25524 Itzehoe

Tel. 04821 / 17-4215

Fax 04821 / 17-4250

www.isit.fraunhofer.de

seminarteam@isit.fraunhofer.de

Weitere Seminarangebote entnehmen Sie unserem Programm. Wir führen auch In-House-Seminare im Kundenauftrag durch. Sprechen Sie uns gerne an.

Hotel

Für Übernachtungen empfehlen wir das Hotel Mercure Klosterforst Itzehoe. Die aktuellen Firmenkonditionen erfragen Sie bitte bei uns.

Schriftliche Anmeldungen sind bis zum 27. Februar 2015 erbeten

Anmeldung

Hiermit melden wir folgende Person(en) verbindlich zu der Veranstaltung „Lotpastenapplikation“ an:

Name _____

Firma _____

Abteilung _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____

eMail _____

Weitere Teilnehmer

Name _____

Tel. _____ eMail _____

Name _____

Tel. _____ eMail _____

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten zwecks Erstellung einer Teilnehmerliste an andere Teilnehmer weitergegeben werden und dass Fotos, die während des Seminars aufgenommen werden, veröffentlicht werden dürfen (ggf. bitte streichen).

Firmenstempel, Datum und rechtsverbindliche Unterschrift

Unterschrift _____

Zulassung zur Veranstaltung nur nach Eingang der Teilnahmegebühr. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Fraunhofer-Gesellschaft. Stornogeühren bis 2 Wochen vor der Veranstaltung 20 %, danach 100 % des Rechnungsbetrags; die Anmeldung kann jedoch auf Ersatzteilnehmer übertragen werden. Der Veranstalter behält sich kurzfristige Programmänderungen sowie Absage aus unvorhersehbaren Gründen vor.

Lotpastenapplikation

Technologien, Prozessoptimierung,
Fehlervermeidung

9. - 10. März 2015, Itzehoe

